

OOBO1 CROOMY POT STREETHER FLESTI CHEALING INDUSTRIES THE STREETHER STREETHER FLESTI CHEALING INDUSTRIES THE STREETHER FLESTI CHEALING IN TH Hi3516AV300 Demo 单板

用户指南

文档版本

发布日期

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明



(A) THISILICON 、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有领导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
Rednord

Technolog

Te 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前

概述

本文档主要介绍 Hi3516AV300 Demo 单板基本功能特点和硬件特性、多功能硬件配 ial Lectuology Co., into 置、软件调试操作使用方法。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516A	V300 100

读者对象

本文档(本指南 主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新 内容。

修订日期	版本	修订说明
2019-02-13	00B01	第一次临时版本发布

前	言	
1	概述	
1	<i>"</i>	
	1.2 产品交付件清单	
	1.3 相关组件	70.,
2	运件人 切	100)
2	硬件介绍	1 de la companya del companya de la companya del companya de la co
	2.1 结构与接口	, 1, 2)
	2.2 GPIO 的分能	wet.
3	操作指南	
	3.1 注意事项	Zing.
	3.2 单板设置	C. C
	3.3 拨码开关使用方法	
		A Company of the Comp
		and the second
	, of	<i>y</i> ,
	24	
	900	
	edgn,	seather fishing



插图目录

图 2-1 Hi3516AV300 Demo 板的接口结构示意图	2
图 3-1 拨码开关使用方法示意图	7

cooper on y for spentien from charling industrial Technology co. . Ltd.



表格目录

表 2-1 Hi3516AV300 Demo 外部接口说明	2	2
表 2-2 Hi3516AV300 Demo 单板中的 GPIO 分配	3	3
表 3-1 启动模式的配置		5
表 3-2 JTAG 的配置		

Constant only for sheather fishi charting Industrial Technology Co



1.1 简介

Hi3516AV300 Demo 单板是针对海思 Hi3516AV300 媒体处理芯片开发的演示评估板, 用于给客户展示 Hi3516AV300 芯片强大的多媒体功能和丰富的外围接口,同时为客户 提供基于 Hi3516AV300 芯片的硬件参考设计, 使客户只需要简单修改 Demo 板上的模 块电路,就可以完成产品的硬件开发。

1.2 产品交付件清单

- ../**戶**里

 Demo 单板交付件主要包括以下数据:

 Hi3516AV300 Demo 板 xiii

 sensor 板 1 ++ Hi3516AV300 Demo 板鈴HI3516AV300DMEB
- 电源适配器, 规格: 输入 100V AC~240V AC, 50Hz; 输出 12V DC, 2A
- 2 颗 16bit (富宽 DDR3, 2Gb*2, 型号 H5TQ2G63GFR
- 16MB Sen nor flash, 型号 MX25L12835

1.3 相关组件 (1.3 相) (1.3 相关组件 (1.3 相) (1.3 相) (1.3 相) (1.3 相) (1.3 相)

以下所列组件不包含在 Hi3516AV300 Demo 单板的包装之内,但它们是用户程序调试 过程中的必备组件,请自备。

- 网线
- 电视机、音响和摄像头等音视频接收设备
- 串口线



2 硬件介绍

2.1 结构与接口

Hi3516AV300 Demo 板的接口示意图如图 2-1 所示。

图2-1 Hi3516AV300 Demo 板的接口结构示意图

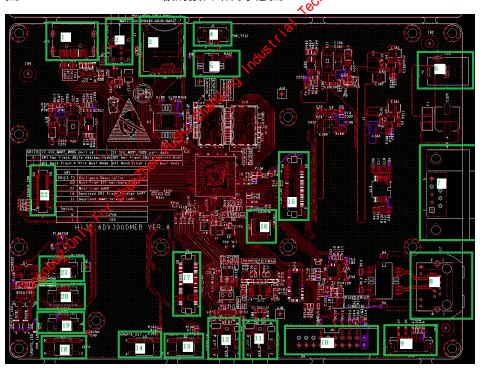


图 2-1 中的各接口说明如表 2-1 所示。

表2-1 Hi3516AV300 Demo 外部接口说明

序号	说明
1	HDMI 接口

序号	说明
2	USB2.0 接口
3	SD卡座
4	CORE 电源与 DDRIO 电源测试接口
5	拨码开关 SW3
6	单板电源接口
7	UART0 接口
8	RJ45 百兆以太网接口
9	I2S 接口
10	JTAG 接口
11	JTAG 接口 ADUIO_OUT AUDIO_IN 按键 KEY1 UPDATE_MODE 按键 LCD 连接器 拨码开关 SW1 Cranting SDIO1 WIFL 连接器
12	AUDIO_IN COMPONIA
13	按键 KEY1
14	UPDATE_MODE 按键
15	LCD 连接器 in the second
16	拨码开关 SW1 craft
17	SDIO1 WIFL 连接器
18	按键 KEN 2
19	UARTI
20	UART1 ODC-IRIS 接口 P-IRIS 接口
21 abity	P-IRIS 接口
22005	60pin Sensor 接口

2.2 GPIO 的分配

Hi3516AV300 Demo 单板中的 GPIO 分配如表 2-2 所示。

表2-2 Hi3516AV300 Demo 单板中的 GPIO 分配

管脚	GPIO 管脚	DMEB 板
I2C7_SCL/GPIO10_6 GPIO10_6		TP点



管脚	GPIO 管脚	DMEB 板
I2C7_SDA/GPIO10_7	GPIO10_7	TP点
PWM1/GPIO6_7	GPIO6_7	DC_IRIS_PWM4/PWM_OUT0_LCD,默认 PWM_OUT0_LCD
UART1_CTSN/GPIO5 _1/UART4_TXD	GPIO5_1	WIFI_LED 控制,输出高灯亮,低灯灭
UART1_RTSN/GPIO5 _0/UART4_RXD	GPIO5_0	UPDATE_LED 控制,输出高灯亮,低灯灭
LSADC_CH1/GPIO10 _4	GPIO10_4	接 SGM8903 MUTE 管脚
GPIO0_3/IR_IN/LCD_ DATA18	GPIO0_3	TP_RST/P_IRIS_CONTROL1 复用,默认 TP_RST 、 、 、
GPIO0_4/LCD_DATA 21	GPIO0_4	TP_INT/P_IRIS_GONTROL2 复用,默认TP_INT
GPIO0_5/LCD_DATA 22	GPIO0_5	LCD_RSTO_IRIS_CONTROL3 复用,默认 LCD_RST
GPIO0_6/LCD_CLK/V OU_CLK	GPIO0_6	DIS_FLOW_CTRL/P_IRIS_CONTROL4 复 ,默认 DIS_FLOW_CTRL

Coodan Only For sheathen Fushi Chanling



3 操作指南

3.1 注意事项

Hi3516AV300 Demo 单板适用于实验室或者工程开发环境。公在开始操作之前,请先阅读以下注意事项:

注意

任何情况下均不能对单板进行热插拔操作。

- 在拆封单板包装与安装之前。为避免静电释放(ESD)对单板硬件造成损伤,请 采取必要的防静电措施。
- 手持单板时请拿单板的边沿,不要触碰到单板上的外露金属部分,以免静电对单板元器件造成损坏。
- 请将 Hi3516Axx000 Demo 单板放置于干燥的平面上,并保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备(如: 医疗设备)等。
- 请对照图 2-1,熟悉 Hi3516AV300 Demo 单板的结构布局,确保能够在单板上辨认出可操作部件,如开关、连接器以及指示灯的位置。

3.2 单板设置

Hi3516AV300 Demo 单板通过按键和选焊电阻,选择 Hi3516AV300 芯片的工作模式,如表 3-1 所示。

表3-1 启动模式的配置

启动模式	值	操作方法	备注
BOOT_SEL[1:0]	00	拨码开关 SW1.3 和 SW1.2 拨到 0	BOOT FROM SPI FLASH。



启动模式	值	操作方法	备注
	01	拨码开关 SW1.3 拨到 0, SW1.2 拨 到 1	BOOT FROM eMMC o
	10	拨码开关 SW1.3 拨到 1, SW1.2 拨 到 0	FASTBOOT UPDATE SPI FLASH(default)
	11	拨码开关 SW1.3 和 SW1.2 拨到 1	FASTBOOTUPDATE eMMC(default)
[SFC_DEVICE_MODE: SFC_BOOT_MODE]	00	拨码开关 SW1.0 拨到 0;去掉 R188,焊接 R367。	SPI NOR FLASH, 寻址模式 为 3 Byte mode。
	01	拨码开关 SW1.0 拨到 0;去掉 R367,焊接 _{Lec} ^M	SPI NOR FLASH,寻址模式 为 4 Byte mode。
	10	拨码开关 SW1.0 拨到 1;去掉 . 18 88,焊接 R367。	SPI NAND FLASH, 寻址模式为 1 wire boot mode。
HED ATE MOSE	Sil	拨码开关 SW1.0 拨到 1;去掉 R367,焊接 R188。	SPI NAND FLASH, 寻址模 式为 4 wire boot mode。
UPDATE_MODE	0	S3 按键按下	Enable UPDATE FROM SDIO0 or USB .
UPDATE_MODE	1	S3 按键不按下	Disable UPDATE_MODE(default)。

表3-2 JTAG 的配置

启动模式	值	操作方法	备注
JTAG/SPI1/I2S	0	拨码开关 SW3.0 拨到 0	JTAG.
	1	拨码开关 SW3.0 拨到 1	SPI1/I2S(SPI1 与 I2S 通过电阻选焊)。



3.3 拨码开关使用方法

拨码开关如图 3-1 所示,右侧为 1,左侧为 0。

图3-1 拨码开关使用方法示意图

